

EPOXY 4044

特性

- 用于印刷应用
- 单组件环氧胶
- 热固化
- 高剪切强度
- 稳定的操控性能
- 适用于高速贴片机
- 符合 REACH 和 ROHS 标准

特点

Epoxy 4044 是单组件环氧胶，用于回流焊或波峰焊装配，粘合 SMT 元件和双面 PCB 板。该产品具抗剪切稀化性，快速热固化性能。Epoxy 4044 的粘度和表面张力提供了与高速贴片机一起使用所需的粘合力。

物理特性

参数	值
外观	浓液体
气味	芳香（轻微）
颜色	红色
粘度	600-1,000 kcps
比重	1.13 (water = 1) 典型值
沸点	>260°C

机械性能

参数	值
热变形温度	97°C 典型值
拉伸强度	11,500 psi 典型值
延伸性%	4.6 典型值
拉伸模量	4.9 psi x 10 ⁵ 典型值
固化90秒	150°C 典型值
附着力- C1206	≈ 12 lbs 典型值
5°剪切强度- C1206	≈ 6 lbs 典型值
力矩: IPC SM817 TM-650 2.4.42:	C-1206 bare FR4 (in.oz.) 11 典型值

处理&储存

非冷藏保质期	6 个月	室温
--------	------	----

请勿冷藏此产品。请勿储存靠近火源或明火。避免阳光直射，可能会降低产品质量。请勿将新的和使用过的黏胶储存在同一容器内。如果材料硬化或结晶，可将其加热 8 小时到 40°C (104°F) 至可用状态。

应用

Epoxy 4044 可直接使用，提供针筒、弹筒和瓶装。当在钢网印刷时，使用干净的钢网，将环氧树脂点在钢网上，直径约 1 厘米。粘胶强度因元件类型、胶粘点的大小、固化和阻焊膜不同。

清洁

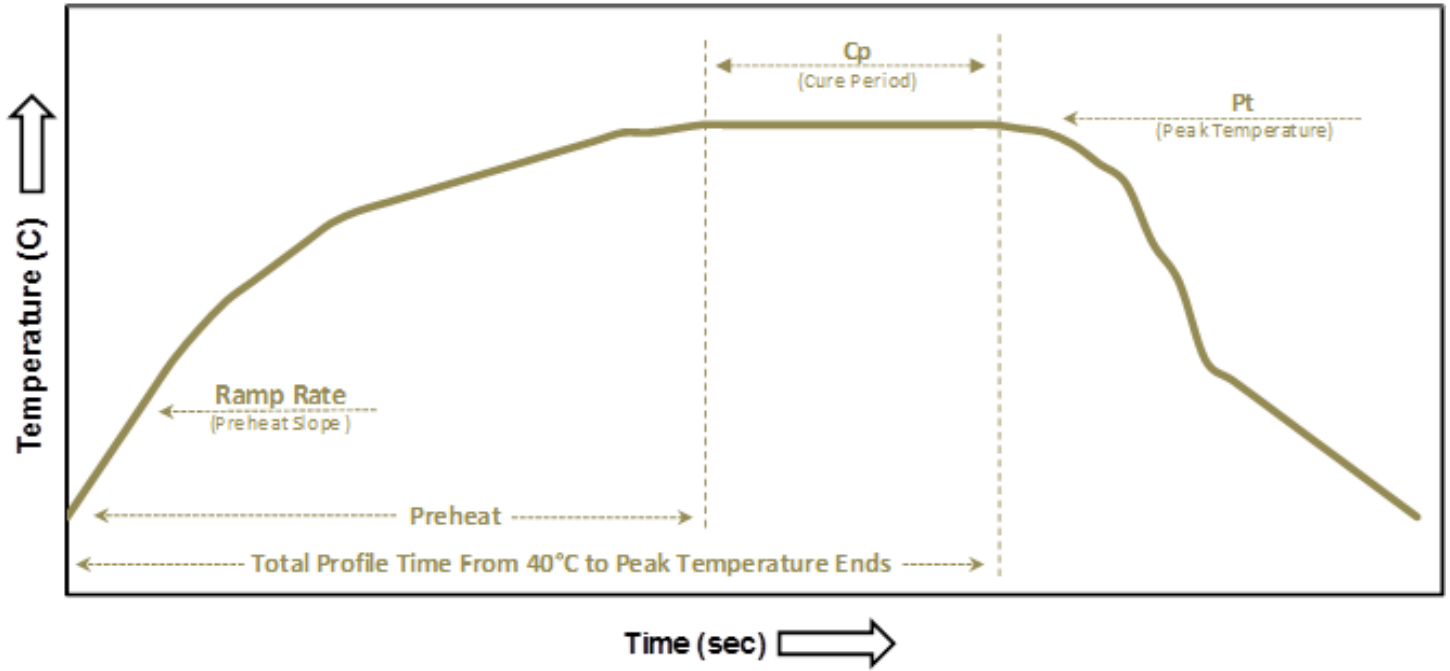
可用 IPA 去除基板上未固化的粘合胶，已固化或粘合了元件，加热至 120°C (250°F) 可软化 Epoxy 4044，以便去除。

安全

保持通风并使用适当的个人防护设备。对任何特定的紧急情况，请参照 SDS 信息。**不要在未核准容器内处理任何有害物质。**

参数	时间	温度
----	----	----

推荐固化曲线



曲线特性	参数
升温斜率	1°C-2.5°C/秒
加热从 40°C 到 100°C	40-80 秒
加热从 100°C 到 120°C	50-70 秒
峰值温度 (Tp)	120°C-125°C
至峰值时间	60 秒
曲线合计时间	2.5-3.5 分钟

*曲线信息仅作参考。曲线可能因工艺和材料的可变因素而有所不同。